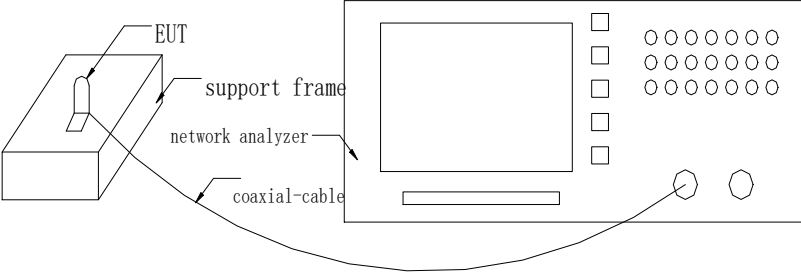
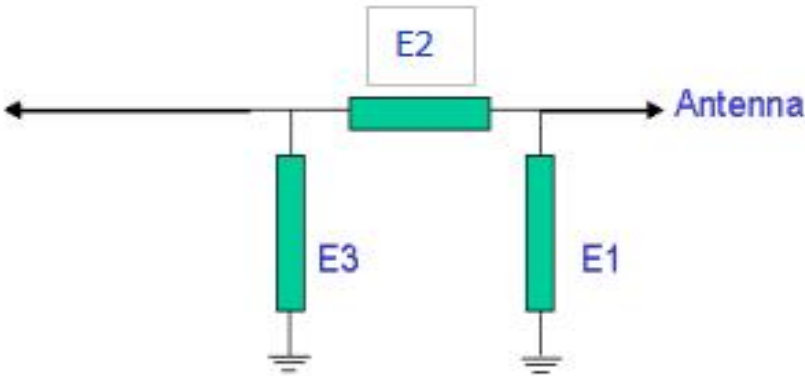
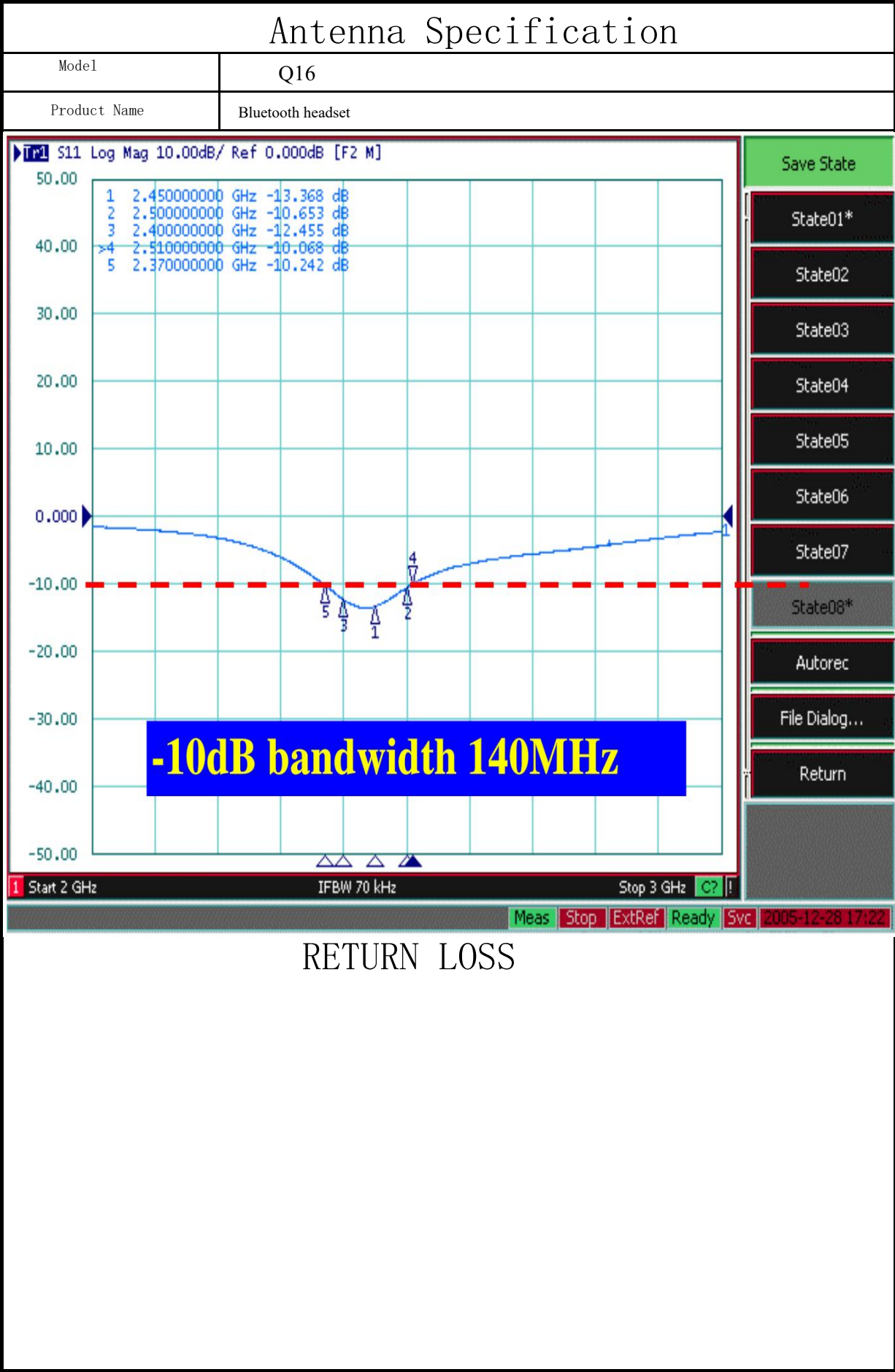
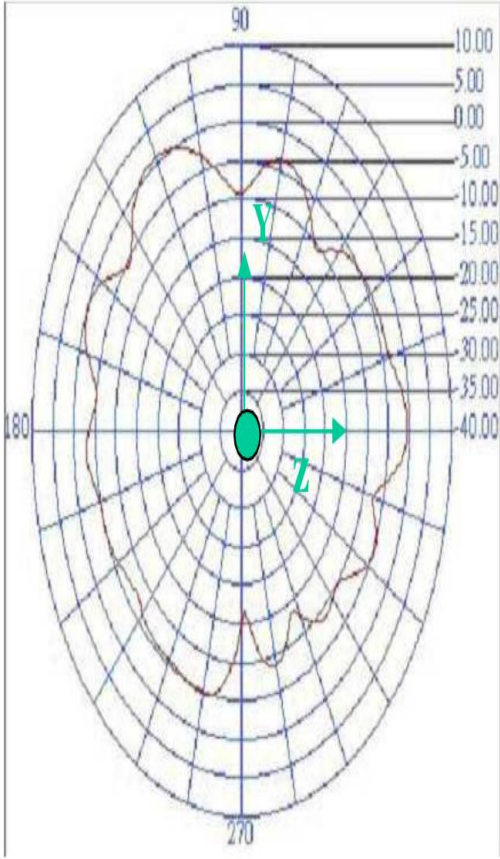
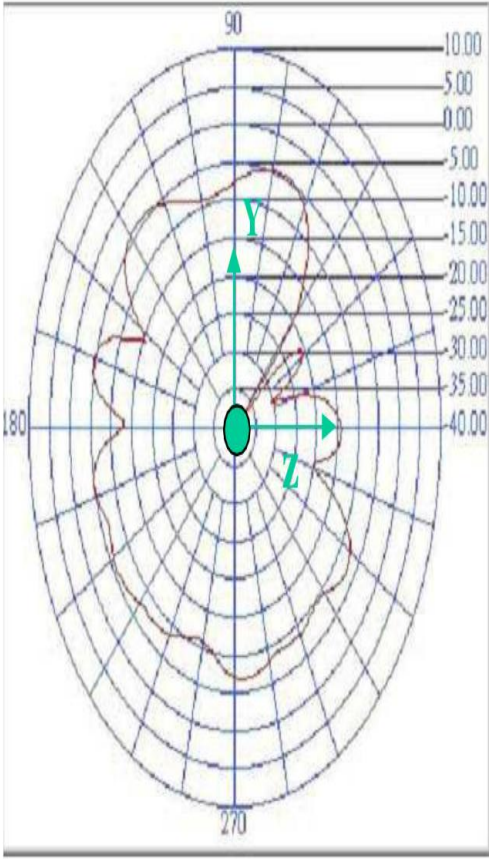


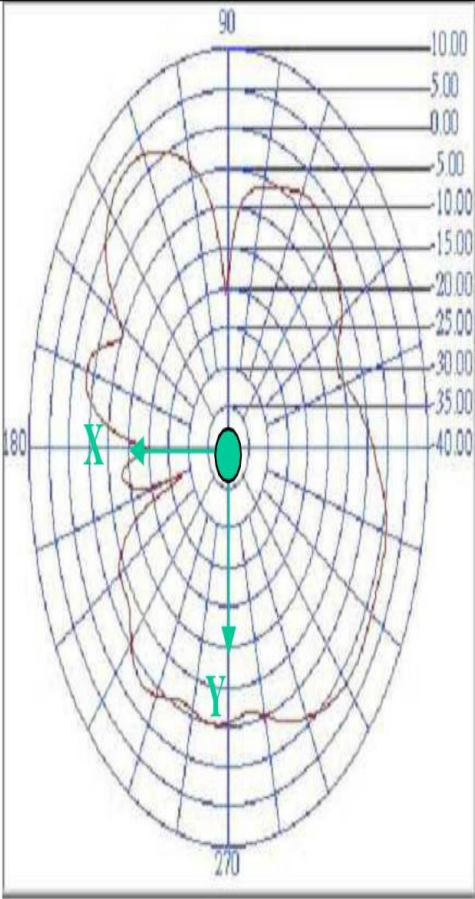
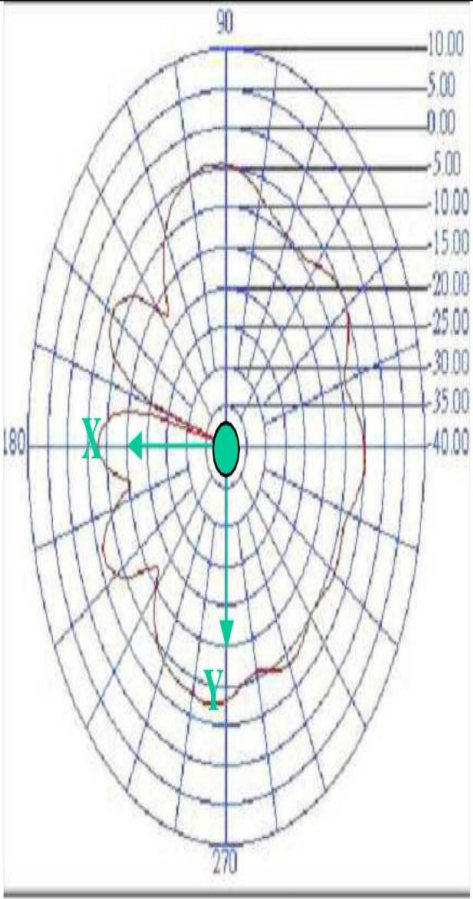
Antenna Specification		
Model		Q16
Product Name		Bluetooth headset
electricity	1. 带宽	2.402GHz ~2.480GHz
	2. 输入阻抗	50 Ω
	3. VSWR	When assembled with the specified prototype, it is placed naturally for measurement.
		2.402GHz ~2.480GHz Below 1.5
	4.GAIN	2.402GHz ~2.480GHz GAIN=3.19dBi(Typical)
		test method:
		(一) Assemble the antenna under test (DUT) on the specified prototype
		(二) Connect the test point on the test piece to the network analyzer with a 50 Ω coaxial cable. Install a magnetic ring on the test cable to reduce the influence of induced current.
		(三) The prototype was placed on a stand with a height of 20cm to test the VSWR when OPEN or CLOSE.
		(四). Install the test circuit as shown below.
		
		(五). The test environment is not specified. (No large metal objects around, carried out in normal temperature and humidity)
	4.allowable power	1W
	5.Operating temperature	-25~+65℃
	6.storage temperature	-40~+85℃

Antenna Specification			
Model	Q16		
Product Name	Bluetooth headset		
BLUE TOOTH ANTENNA 匹配电路 			
Matching specification	E1	NC	NC
	E2	1.2NH	1NH
	E3	2.4PF	2, 4PF
		Left	Right
Antenna configuration	Single-pole FPC antenna		



天线规格书	
Model	Q16
Product Name	Bluetooth headset
Y-Z Plane Average Gain=-3.185 dBi	Horizontal  Peak Gain = 0.95dBi Average Gain = -4.26 dBi
	Vertical  Peak Gain= -4.05dBi Average Gain=-8.03 dBi
Y-Z PLANE	

天 线 规 格 书

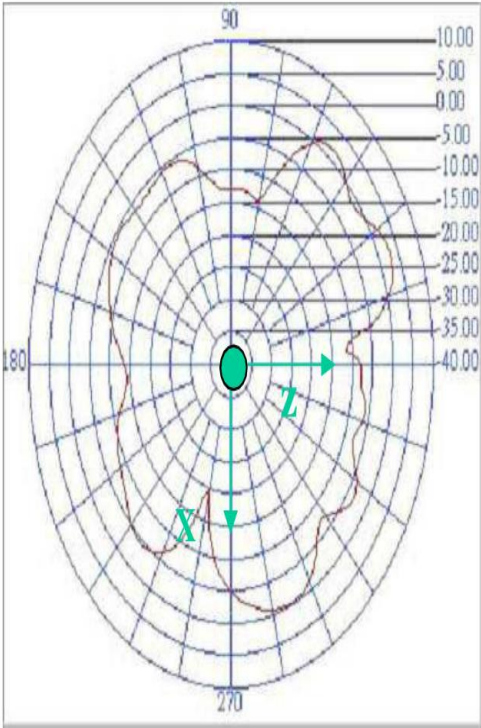
Model	Q16	
Product Name	Bluetooth headset	
X - Y Plane Average Gain= -1.543 dBi	 Peak Gain= 3.19 dBi Average Gain= -2.65 dBi	 Peak Gain= -4.48 dBi Average Gain= -8.02 dBi
	X-Y PLANE	

天线规格书

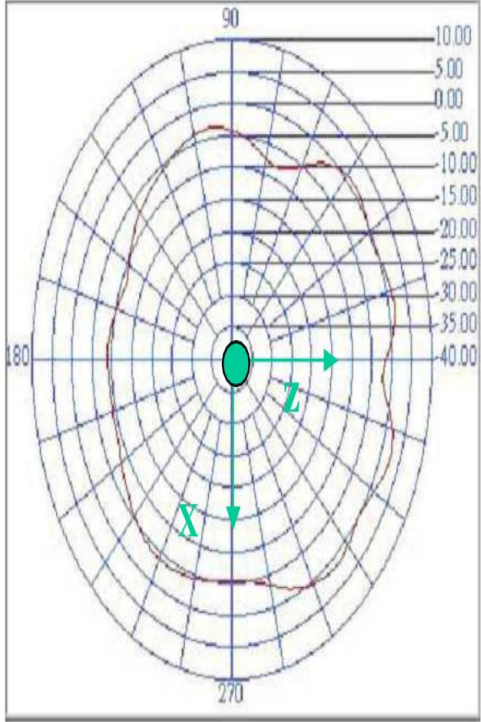
Model	Q16
Product Name	Bluetooth headset

X - Z
Plane

Average
Gain=
-0.99 dBi



Peak Gain= 3.05 dBi
Average Gain= -4.10dBi

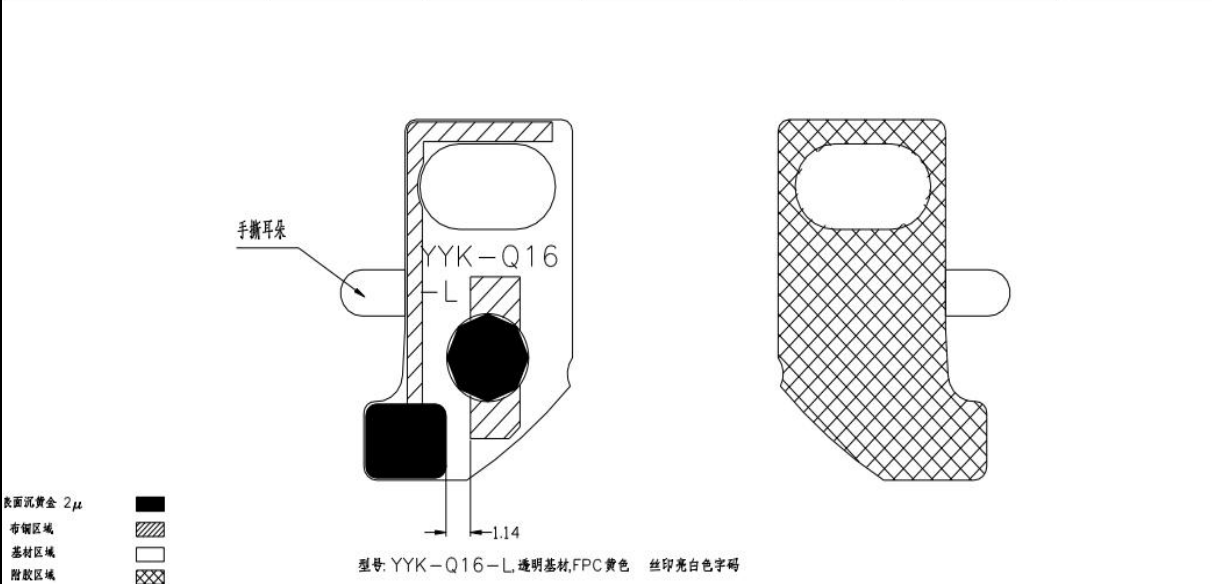


Peak Gain= 2.49 dBi
Average Gain= -2.47 dBi

X-Z PLANE

天线规格书

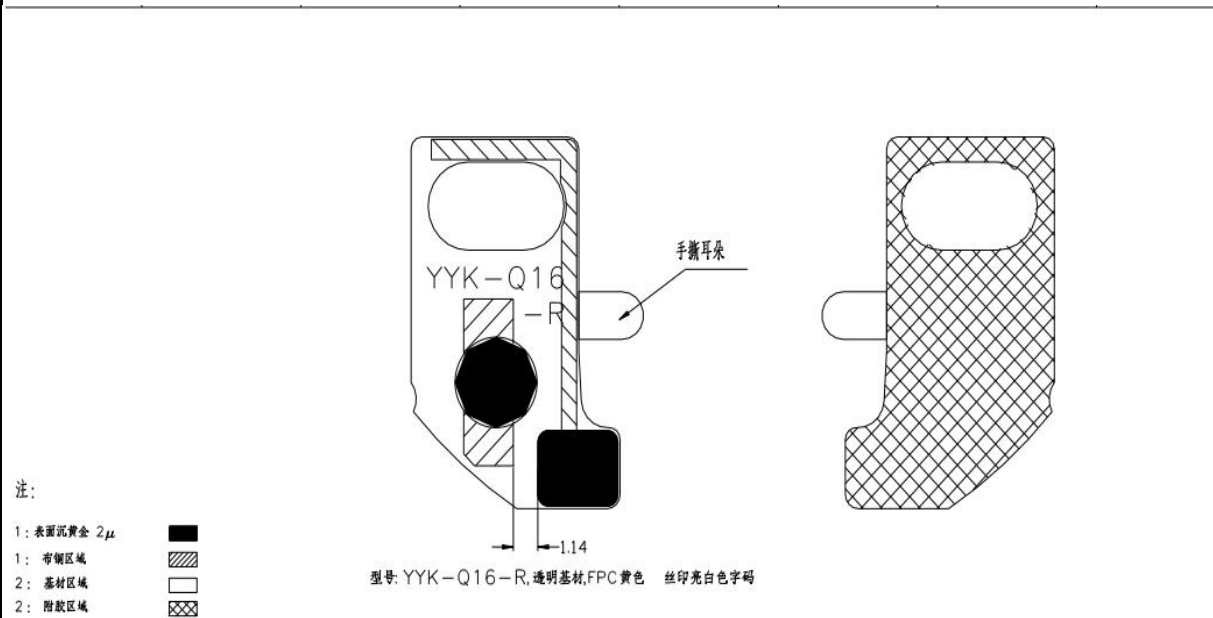
Model	Q16
-------	-----



1. 表面沉金 300 LSE , 厚度在300MP以上, 无附胶区域, 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度;
2. 附胶区域, 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度;
3. 布铜区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
4. 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
5. 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
6. 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
7. 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
8. 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
9. 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
10. 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
11. 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;

深圳市恒信达通讯科技有限公司

第三类注				机种	YYK-Q16-L	日期	2023-10-28	页码	1/2
未注公差参照标准	10以下	±0.05	0.02	品名	FPC	设计	SR	审核	
	10~20	±0.08	0.03	料号		工程			
	20~40	±0.10	0.04	材料		制程			
	40以上	±0.15	0.02	表面处理		确认			
请见实物图				外观处理		单位	mm	比例	FIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



注:
1: 表面沉金 300 LSE , 厚度在300MP以上, 无附胶区域, 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度;
2: 附胶区域, 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度;
3: 布铜区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
4: 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
5: 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
6: 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
7: 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
8: 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
9: 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
10: 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;
11: 附胶区域 180° 附胶手撕与基材一致, 厚度在基材厚度, 厚度在基材厚度;

深圳市恒信达通讯科技有限公司

第三类注				机种	YYK-Q16-R	日期	2023-10-28	页码	2/
未注公差参照标准	10以下	±0.05	0.02	品名	FPC	设计	SR	审核	
	10~20	±0.08	0.03	料号		工程			
	20~40	±0.10	0.04	材料		制程			
	40以上	±0.15	0.02	表面处理		确认			
请见实物图				外观处理		单位	mm	比例	FIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10